

貳、公司簡介

一、設立日期：86 年 5 月 15 日

二、公司沿革

- | | | |
|------|--------|--|
| 86 年 | 05 月-- | 力成科技股份有限公司成立，實收資本額 6 億元整。 |
| | 08 月-- | 取得力晶半導體 DRAM、旺宏電子 FLASH 測試訂單，開始記憶體積體電路測試服務。 |
| 87 年 | 02 月-- | 經財政部證券暨期貨管理委員會核准公開發行。 |
| | 05 月-- | 通過 ISO 9002 品質管理系統驗證(測試)。 |
| 88 年 | 01 月-- | 金士頓集團(Kingston Group)蔡篤恭先生接任董事長。 |
| 89 年 | 10 月-- | 購入力晶半導體竹北分公司後段設備，增加封裝業務，開始提供客戶封裝測試一元化服務。 |
| 90 年 | 01 月-- | 取得掛牌為保稅工廠。 |
| | 05 月-- | 通過 ISO 9002：1994 品質管理系統驗證(封裝、測試)。 |
| 91 年 | 03 月-- | 通過 TOSHIBA 封裝及測試品質認證，取得 TOSHIBA FLASH 封裝測試訂單，提供 TOSHIBA 封裝測試一元化服務(Turn-Key Service)。 |
| | 10 月-- | 股票於興櫃市場掛牌交易。 |
| 92 年 | 01 月-- | 榮獲 ISO 14001：1996 環境管理系統驗證合格。 |
| | 04 月-- | 股票於櫃檯買賣中心掛牌交易。 |
| | 08 月-- | 通過 ISO 9001：2000 品質管理系統驗證。 |
| 93 年 | 09 月-- | 通過 OHSAS 18001：1999 安全與衛生管理系統驗證。 |
| | 11 月-- | 公司股票於台灣證券交易所掛牌交易。 |
| | -- | 晶圓級測試正式進入量產。 |
| 94 年 | 02 月-- | 導入綠色產品(GP)管理系統。 |
| | 05 月-- | 通過 Sony Green Partner 驗證。 |
| | 12 月-- | 以「購買法」簡易合併 100%轉投資之力嘉投資有限公司。 |
| | -- | 開始生產 microSD Card。 |
| | -- | 通過 ISO 14001：2004 環境管理系統驗證。 |
| 95 年 | 01 月-- | 研發技術中心成立。 |
| | -- | 首次發行全球存託憑證(現股)於盧森堡證券交易所掛牌交易。 |
| | 08 月-- | 通過 ISO/TS 16949：2002 驗證。 |
| | 12 月-- | 榮獲經濟部技術處「95 年產業創新成果表揚」。 |

96 年	03 月--	發行第一次私募國內無擔保可轉換公司債，發行金額新台幣 34 億 1 仟 2 百萬元。
	08 月--	獲得經濟部國際貿易局「95 年度金貿獎」出進口實績第十名。
	11 月--	榮獲經濟部工業局「第八屆工業精銳獎」。
97 年	03 月--	開始提供邏輯 IC 封裝服務。
	09 月--	榮獲經濟部國際貿易局「96 年度金貿獎」出進口實績第九名。
98 年	08 月--	榮獲經濟部國際貿易局「97 年度金貿獎」出進口實績第五名。
	09 月--	透過海外子公司 Powertech Holding (B.V.I.) Inc.併購 Spansion Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(更名為 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.)並間接取得 Spansion 中國蘇州 MCP 封測廠，後更名為力成科技(蘇州)有限公司，正式跨足大陸地區的封裝測試領域。
99 年	03 月--	於新竹科學園區成立子公司-聚成科技股份有限公司。
	09 月--	榮獲經濟部國際貿易局「98 年度金貿獎」出進口實績第五名。
	--	榮獲經濟部技術處第 18 屆產業科技發展獎之「傑出創新企業獎」。
100 年	08 月--	榮獲行政院頒發「創造就業貢獻獎」。
	09 月--	榮獲經濟部國際貿易局「99 年度金貿獎」出進口實績第六名。
101 年	02 月--	透過公開收購取得超豐電子股份有限公司股權 44%。
	04 月--	經超豐電子股東臨時會改選，力成正式入主超豐電子。
102 年	07 月--	主要客戶爾必達公司被美光科技收購，業務對象變更為美光科技。
	09 月--	榮獲經濟部國際貿易局「101 年度金貿獎」出進口實績第十名。
	11 月--	湖口 3C 新廠落成啟用，並將總公司遷址於此。
103 年	02 月--	與美商 TESSERA 達成技術授權合約之訴訟和解，並同意提前終止授權合約，有助於本公司未來代工業務成本的降低。
	07 月--	取得新加坡 Nepes Pte. Ltd. 100% 股權，並更名為 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.。
	12 月--	與美光科技簽訂半導體封裝投資合約，本公司未來將於中國大陸西安設立封裝廠，提供封裝服務。
	--	吸收合併子公司「聚成科技股份有限公司」，並於原址改設竹科分公司。
104 年	04 月--	正式加入電子行業公民聯盟(EICC)(現更名為責任商業聯盟 RBA)。
	05 月--	設立子公司-力成半導體(西安)有限公司。

- 105 年** 04 月-- 榮獲經濟部國際貿易局「104 年度金貿獎--最佳貿易貢獻獎」第四名。
- 10 月-- 取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會 2016 年「台灣 Top 50 企業永續報告獎—電子資訊製造業金獎」。
- 12 月-- 取得社會責任管理系統(SA8000)認證。
- 106 年** 01 月-- 設立日本子公司--力成科技日本合同會社(Powertech Technology (Japan) Limited)。
- 06 月-- 完成公開收購日本上市公司 Tera Probe, Inc.之股權，合計持股達 60.65%，正式成為力成子公司。
- 08 月-- 完成併購 Micron Akita Inc.(美光秋田株式會社)100%股份，並更名為 Powertech Technology Akita Inc.(力成科技秋田株式會社)。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會 2017 年「Top 50 企業永續報告 金獎」。
- 107 年** 01 月-- 榮獲英國媒體路透社母公司湯森路透（Thomson Reuters）列入「全球百大科技領袖」（Top 100 Global Technology Leaders）優秀企業名單。
- 09 月-- 力成新竹科學園區三廠開始興建，啟動全球第一座使用面板級扇出型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP) 製程之量產基地，正式佈局高階封裝領域。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會 2018 年 TCSA 台灣企業永續獎之「Top 50 企業永續報告 白金獎」及「Top 50 台灣企業永續獎」。
- 108 年** 05 月-- 榮獲重要客戶頒發「Preferred Quality Supplier Award」與「Good Partner Award」獎項。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會 2019 年 TCSA 台灣企業永續獎之「年度最佳企業永續報告獎」及「Top 50 台灣企業永續獎」。
- 12 月-- 通過 ISO 5001 能源管理系統認證。
- 109 年** 08 月-- 榮獲 2020「天下 CSR 企業公民獎」大型企業組第 45 強。
- 09 月-- 新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.縮減營業規模並轉型為控股公司。
- 10 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會 2020 年 TCSA 台灣企業永續獎之「台灣十大永續典範企業獎(製造業)」、「企業永續報告白金獎」、「創新成長獎」及「性別平等獎」等四項殊榮。